

Title (en)

Component for a building, in particular wall, roof or ceiling element component and accompanying method of production

Title (de)

Bauteil für ein Gebäude, insbesondere Wand-, Decken- oder Dachelementbauteil, und zugehöriges Herstellverfahren

Title (fr)

Composant pour un bâtiment, notamment composant de mur, de plafond ou de toit et procédé de fabrication associé

Publication

EP 2395164 A2 20111214 (DE)

Application

EP 11004807 A 20110610

Priority

DE 102010023708 A 20100614

Abstract (en)

The component comprises a bulking material (11) or adjustment particles and a layer (10) for building insulation or removal of building loads, where a binding material (12) is provided with resin, particularly epoxy resin or plastic resin or natural resin. The two layers are fastened or stuck together by the binding material. An independent claim is also included for a method for producing components.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Bauteil, beispielsweise für ein Gebäude, vorzugsweise ein Fertigbauteil, insbesondere ein Wand-, Dach- oder Deckenelementbauteil, mit zumindest einer ersten Schicht (10), die ein Bindemittel (12) und ein Blähmaterial (11) und/oder Zuschlagteilchen (11) aufweist. Ferner kann das Bauteil zumindest eine zweite Schicht (20) umfassen. Es ist möglich, dass das Bindemittel (12) der ersten Schicht (10) ein Harz, insbesondere ein Epoxidharz ist. Es ist auch möglich, dass die erste Schicht (10) und die zweite Schicht (20) mittels des Bindemittels (12) der ersten Schicht (10) aneinander befestigt werden und/oder aneinander haften. Ferner wird ein zugehöriges Herstellverfahren bereitgestellt.

IPC 8 full level

E04B 1/02 (2006.01); **E04C 2/20** (2006.01); **E04C 2/24** (2006.01); **E04C 2/288** (2006.01)

CPC (source: EP)

E04B 1/02 (2013.01); **E04C 2/049** (2013.01); **E04C 2/288** (2013.01)

Cited by

EP3241811B1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2395164 A2 20111214; **EP 2395164 A3 20130213**; DE 102010023708 A1 20111215

DOCDB simple family (application)

EP 11004807 A 20110610; DE 102010023708 A 20100614